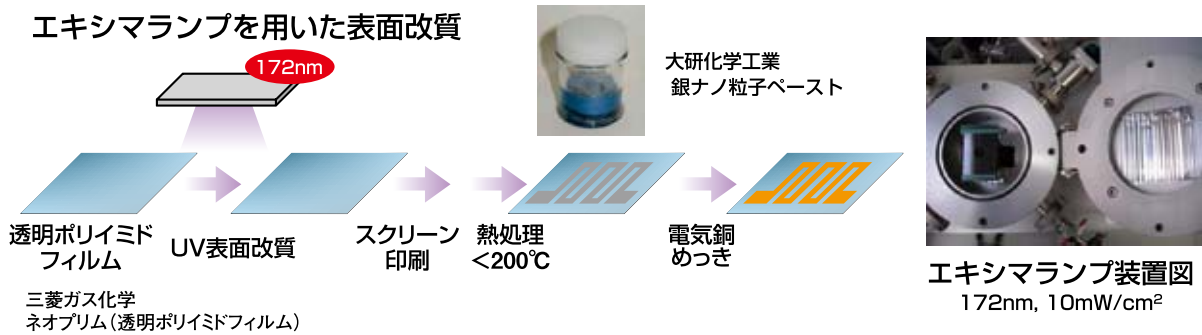




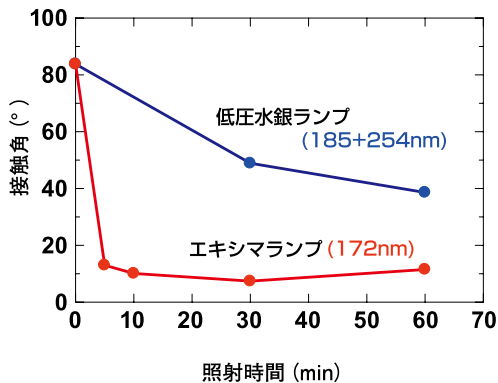
耐熱性フィルムへの高密着金属配線の低温形成技術

金属ナノ材料を用いたフレキシブルなプリントエレクトロニクスデバイスの開発において、金属ナノ材料の高分子フィルム基板への密着性向上が課題となっています。当研究室では、高密着性金属配線形成技術の低温化プロセスについて研究を進めています。

エキシマランプを用いた表面改質

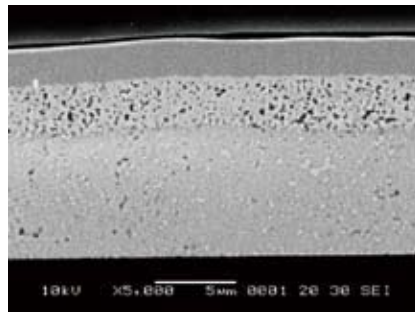
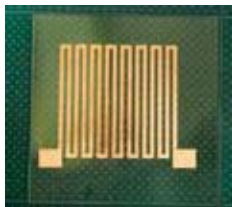
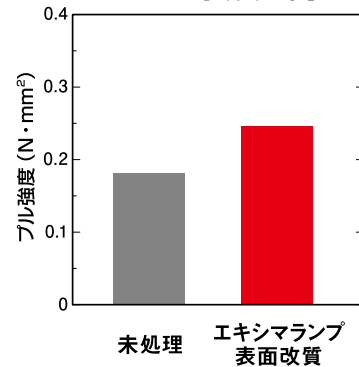


UV処理による接触角変化



処理条件	接触角
—	84°
エキシマランプ 空气中	11°
エキシマランプ 窒素中	39°
低圧水銀ランプ 空气中	39°

表面改質による プル強度の向上



断面電子顕微鏡写真

銅めっき
銀ペースト
フィルム

